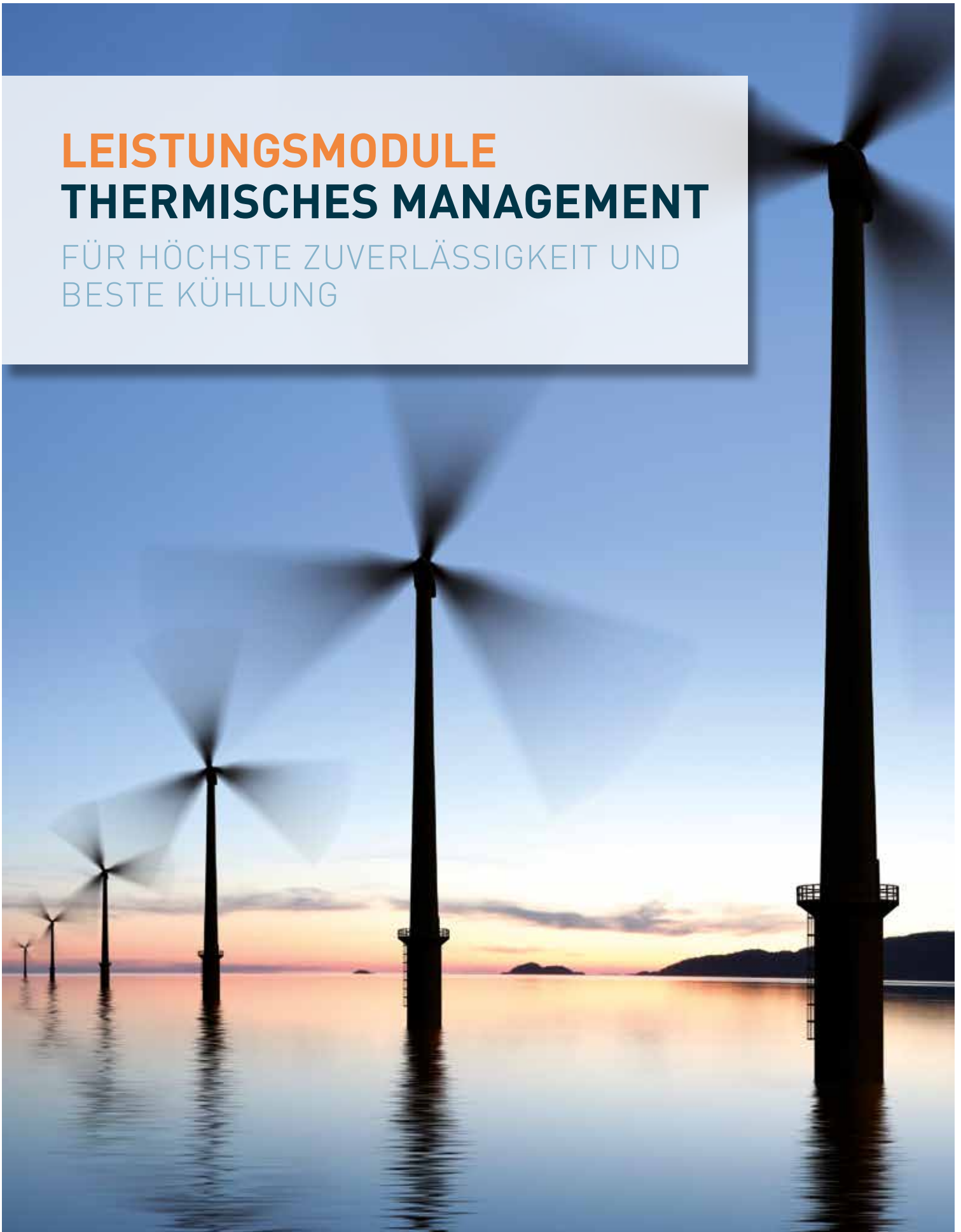


LEISTUNGSMODULE THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND
BESTE KÜHLUNG



LEISTUNGSMODULE THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTE KÜHLUNG



MODULARE AUFBAUTECHNIK

HALA Hochleistungs-Kontakt-Interfacematerialien

Phase Change Filme

- TPC-W-PC
- TPC-T-AL-CB
- TPC-R-AL

Phase Change Druckbar

- TPC-Z-PC-HT
- TPC-X-PC-NC-HT

Grafit Folie

- TFO-S-CB

Grafit Folie / pyrolytisch

- TFO-Y-PG
- TFO-ZS-PG

Silikon Folie

- TEL-Z-SI

- TEL-ZS-SI

Silikon Wärmeleitpaste

- TGR-S-SI

Silikonfreie Wärmeleitpaste

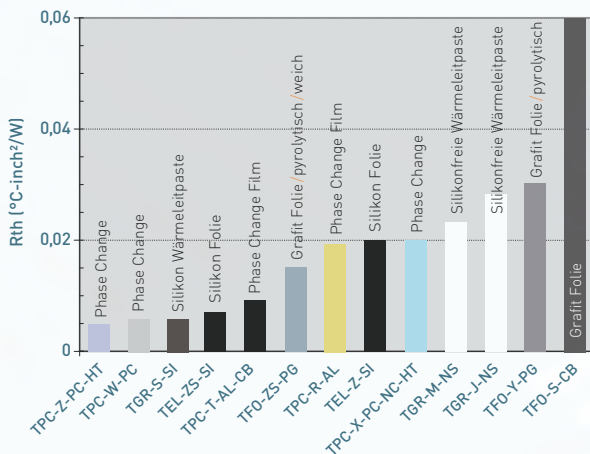
- TGR-J-NS
- TGR-M-NS



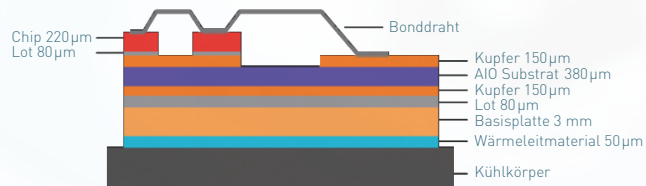
Stand 11 / 2018

infineon Modul EconoPACK™+

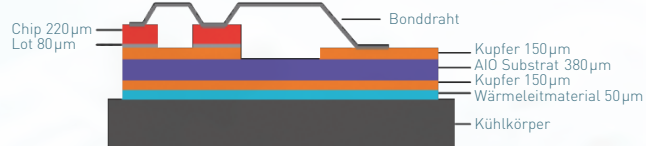
RTH WERTE



AUFBAU-SCHEMA



Typischer Modulaufbau mit Basisplatte (Kupfer)



Typischer Modulaufbau ohne Basisplatte

EFFEKTE

- Maximaler thermischer Kontakt
- Minimaler Wärmewiderstand
- Mechanischer Toleranzausgleich
- Verbessertes Wirkungsgrad

VORTEILE

- Erhöhte Langzeitzuverlässigkeit
- Minimale Chip Temperaturen
- Homogene Temperaturverteilung
- Trockene Aufbringung



Vincotech Modul

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktleistung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.